

2021 年度第 3 四半期 WEB 決算説明会（2022 年 5 月 12 日開催）**およびアナリストミーティングの主な質疑応答****【3Q 実績・通期予想】****1. 業績予想の修正はないということだが、4Q は3Q 比悪化するのか？ 3Q 実績も上期に続き好調な中、通期（4Q）の見込みは？なぜ上方修正しないのか？**

A: 4Q の受注・売上も 3Q 同様に順調に推移すると見込んでいるが、適時開示基準に達するほどではないため、今回、業績予想の修正は行わなかった。

引き続き半導体・電子・FPD を中心とした高水準の受注高により成長シナリオに変更はない。

2. 3Q 売上総利益率 30.9%が 2Q（32.4%）比、低下したのはなぜか？通期の売上総利益率の見込みは？

A: 利益率の高い半導体・電子が部品長納期化の影響で売上進捗が遅れた一方、FPD は受注・売上が増加し、ミックスが悪化した影響と、部材価格の上昇の一部を吸収しきれなかったことなどにより売上総利益率が 2Q 比低下した。

今期の売上総利益率は期初公表値には及ばない見込みだが、部材価格上昇の影響などを吸収しながら、昨年度の 29.4%から着実に改善している。

今後も引き続きモノづくり力強化に取組み、利益率の改善に取り組んでいく。

3. 3Q の FPD および半導体電子部品の受注高・売上高の用途別内訳は？

A: 別紙のとおり。

4. 3Q の営業利益率順位は？

A: 別紙のとおり。

【部材調達関連等】**5. どのような部材が長納期化しているのか？どのような対策を取っているのか？**

A: 半導体や樹脂関連の不足から制御部品やサーボモータ、コネクタ等が長納期化するとともに、部品製作サプライヤーでも需給逼迫によって全般的に長納期化している。長納期化する電子部品等の範囲が拡大するとともに、納期も更に長くなっている。

対策として、部品・材料の先行手配やサプライヤーの原材料手配協力、標準ユニットの早期部材確保、各メーカーとの定期的な打合せによる協力体制などに加え、海外グループ連携によるグローバルな部品確保の取組などを実施している。

また、取引先や一部の顧客とも入手困難な部品情報を共有し、お互いの協力による部品確保の取組も実施している。さらに仕様変更による部品置き換えも進めている。

6. 装置のリードタイムはどの程度伸びているのか？

A: 装置によっても異なるが、例えば半導体・電子では、様々な対応により 6～8ヶ月程度に抑え込んでいたリードタイムが、部材の長納期化に伴い、足元では 12～14ヶ月となってきている。

7. 部材調達コスト上昇、物流コスト上昇による影響は？

- A: 部材調達コストは足下、急上昇している。当社の装置ビジネスは見積りごとに価格交渉を行うケースが多いことから、都度の価格交渉である程度吸収できる面がありまた、モノづくり力強化による利益率改善によって吸収している面もあるが、部材調達コスト上昇により利益率改善の進捗に遅れが出ている。
- 物流コスト上昇に関しては、顧客に製品を届ける際の物流費は、FOB 等が多く顧客負担となるため、影響は比較的軽微である。

【中国ロックダウン】

8. 中国でのロックダウンの影響について教えてほしい。

- A: 中国でコロナの関係で顧客企業の投資方針・計画に大きな変更が出ているとの話は聞いていない。特に半導体・電子・FPD 関連は国策重点産業であり、中国経済をけん引する役割があるため、投資スタンスは引き続き前向きである。
- 地域によっては直接訪問やインストール作業に制約が発生するケースもあり、売上進捗への影響、物流コスト増、諸経費の増加などの影響が一部発生している。
- また、日本などからの輸入部品調達や中国国内の物流などに時間がかかるケースもあり、売上進捗への影響も出ており、相応の影響が発生しているが、今期業績予想にはそれらを反映している。
- 中国の現地工場の製品はそのほとんどが中国国内向けであること、FPD・半導体・電子の最先端装置は日本・韓国・台湾での生産割合が高く、中国以外での生産代替が効くため、ロックダウンによるグループ全体への影響は限定的である。

【半導体・電子 投資動向】

9. 半導体の設備投資動向の認識に変化はあるか？レガシーノードのロジック投資スピードが落ちるとの見方もあるが、投資が減少しないのか？

- A: ロジック・メモリともに最先端半導体の投資は引き続き活発であり、半導体受注は3Q累計で前年同期比1.5倍、特にロジックはEUV導入で実現した最先端の微細化工程で使うMHM（メタル・ハード・マスク）工程の受注が順調に進み1.6倍になり、メモリはDRAM中心に1.5倍となっている。通期でも同様にロジック・メモリともに増加を見込んでおり、特に最先端投資を中心に半導体投資は中長期的に投資拡大が継続すると認識している。

10. 電子関連はどの用途・地域が伸びたのか？

- A: 3Qまでは日本でのパワーデバイス投資が活発化し、前年同期比1.7倍の受注となった。電子部品（MEMS）も前年同期比3.6倍に増加し、主にアナログIC等電子デバイスや研究開発用向けスパッタ装置等が日本・中国で好調に推移した。
- 通期でも、中国のパワーデバイス投資が伸びると見込んでおり、今後も拡大していくと見込んでいる。

【FPD 投資動向】

11. LCD のパネル価格が下落しているが、FPD の投資動向への影響はないか？ 来期以降はどのような見込みか？

A: タブレット・PC・医療用・車載用・ゲーム用など IT パネル向け LCD の投資が活発化し、新設ライン投資に加えて、高精細化・広視野角に対応した設備増強投資もあり、LCD 関連の受注が増加するとともに、上期には OLED の蒸着装置の大型受注もあり、3Q 累計受注では、2.1 倍の 673 億円に大幅に増加した。通期も年間予想の 730 億円を上回る可能性が高い。

中国の大型パネル工場稼働に伴う韓国メーカーの工場閉鎖方針を前提に中国や台湾のパネルメーカーが需給バランスを考えているようで、特に投資スタンスに変更は見られない。

来期以降も、OLED 化進展・EV バッテリービジネス等により、多少の波はあっても現状の高水準を維持できると考えている。

【コンポーネント・一般産業・マテリアル・その他 投資動向】

12. 半導体・電子、FPD 以外にコンポーネント、一般産業、マテリアル、その他でも受注が好調であるが、それぞれどのような要因で増加したのか？

A: コンポーネントはエレクトロニクス関連向けの製造装置に搭載されるポンプ・計測器・電源などが全般的に増加し、3Q 累計で前年同期比 45 億円受注が増加。一般産業は中国の EV モーター等自動車向け熱処理装置等の投資が増加し、前年同期比 24 億円増加。マテリアルは半導体・電子や FPD の顧客稼働率上昇等により、前年同期比 51 億円増加。その他は表面分析装置が中国を中心にアジアでの投資が活発化し、前年同期比 41 億円増加。半導体・電子、FPD も含め、全品目で前年同期比、受注が増加した。

【来期以降の業績等】

13. 来期以降の業績見込みを教えてください。

A: 8月に来期の計画を説明する。

以上

別紙：品目別実績 内訳割合・営業利益率順位

●受注高 品目別の内訳割合

受注高	FY2021 3Q
半導体電子（億円）	202
・メモリ	約3割
・ロジック	1割弱
・電子部品	4割弱
・パワー半導体	2割強
・実装	一桁台半ば
・その他	0
FPD（億円）	114
・LCD	5割半ば
（大型向け割合）	（大型向け5割弱）
・OLED	約3割
・その他	1割半ば

●売上高 品目別の内訳割合

売上高	FY2021 3Q
半導体電子（億円）	144
・メモリ	3割強
・ロジック	2割弱
・電子部品	2割半ば
・パワー半導体	2割弱
・実装	一桁台半ば
・その他	0
FPD（億円）	217
・LCD	約4割
（大型向け割合）	（大型向け8割半ば）
・OLED	約5割
・その他	1割弱

●営業利益率順位 FY2021 3Q

順位	品目
1	コンポーネント
2	半導体電子
3	FPD
4	その他
5	一般産業
6	材料

全社平均利益率は
 2) 半導体電子と
 3) FPDとの間